

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2026-006

上海集成电路产业投资基金股份有限公司
关于所持华虹半导体有限公司境内股票变动的提示性
公告

信息披露义务人上海集成电路产业投资基金股份有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公告是根据中国证监会《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》第四章第二节的规定披露的提示性公告。

本次变动数量：30,761,109 股

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司境内已发行股票 30,761,109 股，占公司境内已发行股票总数的比例为 5.14%。

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：上海集成电路产业投资基金股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A 单元

法定代表人：李鑫

持股 5%以上的股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	761,403.34	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司（代表“中国人寿-沪发 1 号股权投资计	750,526.16	30.2632%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	划”）		
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	261,052.69	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	174,035.25	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	156,631.54	6.3158%
6	中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	131,544.9467	5.3042%

二、 本次权益变动的基本情况

公司董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及相关公告。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元人民币/股。本次发行股份购买资产的发行股份的数量为 190,768,392 股，各交易对方在本次发行股份购买资产交易中将分别获得公司本次发行股份的数量如下：

交易对方	交易对价（万元人民币）	获得股份的数量（股）
上海华虹（集团）有限公司	538,855.119569	124,332,053
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	133,318.646521	30,761,109
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	86,922.766501	20,056,014
上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）	67,693.682735	15,619,216
合计	826,790.215326	190,768,392

本次发行股份的最终发行数量应以经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册的数量为准。

在不考虑募集配套资金的前提下，以公司 2025 年 11 月 30 日的股东持股情况为基础，本次交易前后上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司境内已发行股票变化情况具体如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持有中国境内 已发行股票数 量（股）	占中国境内已 发行股票总数 比例	持有中国境内 已发行股票数 量（股）	占中国境内已 发行股票总数 比例
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	0	0	30,761,109	5.14%

注：本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

三、 其他事项

本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否取得前述批准及具体取得时间存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

信息披露义务人：上海集成电路产业投资基金股份有限公司

2026年1月1日